ÜRETİCİ: EQUATE | **MALZEME AİLESİ:** LLDPE (Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen)

EFDC-7087

Film Ekstrüzyon Reçinesi

İnce kesitli ambalajlarda üstün delinme direnci ve yüksek tokluk sunan optimize edilmiş film çözümü.

Slip ve Antiblocking Katkılı



NotebookLM

Temel Karakteristikler

Maksimum performans için dengeli fiziksel özellikler.

Akış & Yapı

1.0	MFI (Eriyik Akış İndeksi) (g/10 dk)
0.918	Yoğunluk (g/cm^2)
124	Erime Noktası (°C)
530	Yığın Yoğunluğu (Kg/m^3)

Mekanik Güç

100	Dart Impact (Darbe Dayanımı) (g)
75	Delinme Enerjisi (J/mm)
34 / 26	Çekme Dayanımı (MD/TD) (MPa)
35 / 135	Yırtılma (Elmendorf MD/TD) (N/mm)

Optik Özellikler

%17	Haze (Bulanıklık)
50	Parlaklık (Gloss - 45°)

Değerler 25 mikron kalınlığında ve 2:1 şişirme oranına sahip filmler için tipiktir.

NotebookLM

Uygulama Alanları

İnce yapılı ancak dayanıklılık gerektiren tüm ambalaj projeleri için idealdir.

- İnce kesitli astar filmleri (Thin gauge liner films)
- Elbise kılıfları (Garment bags)
- Tokluk gerektiren endüstriyel ambalajlar
- Delinme direnci aranan tüketici paketleme uygulamaları

%100 Gıda Uyumluluğu

Pişirme sırasında gıdayı muhafaza edecek ambalajlar da dahil olmak üzere tüm gıda temas uygulamaları için uygundur.

US FDA 21 CFR 177.1520

EC Directive 90/128/EEC

NotebookLM

EFDC-7087 Ne Zaman Seçilmeli?

Projeniz aşağıdaki kriterleri taşıyorsa en doğru malzeme profilindesiniz.

1

İnce Film Üretilecekse:

Mükemmel çekilme (draw down) kabiliyeti sayesinde film kalınlığını (gauge) **azaltıp** yüksek performanslı ince üretim yapmak istediğinizde.

2

Yüksek Delinme Riski Varsa:

Paketlenecek ürünlerin ambalajı zorladığı durumlarda; **75 J/mm yüksek delinme enerjisi** ve **üstün tokluk** (toughness) gereksinimlerinde.

3

Yüksek Hız ve Sızdırmazlık Arandığında:

Yüksek hızlı üretim hatlarında kolay işlenebilirlik (machinability) ve güçlü ısıl yapışma (sealability) performansı arandığında.

NotebookLM

Alternatifler Ne Zaman Düşünülmeli?

Aşağıdaki operasyonel senaryolarda farklı reçine gruplarına yönelmeniz önerilir.



Ekstra Dar Kalıp Boşluklarında (Die Gap):

Makine hattınızın kalıp boşluğu (Die gap) 1.8 mm'nin altındaysa. (Bu reçine için optimum > 1.8 mm'dir).



Kristal Berraklığında Optik Beklentilerde:

Amacınız ultra-şeffaf bir film üretmekse. (%17 Haze değeri, standart endüstriyel ambalajlar için uygundur ancak ekstra şeffaflık sağlamaz).



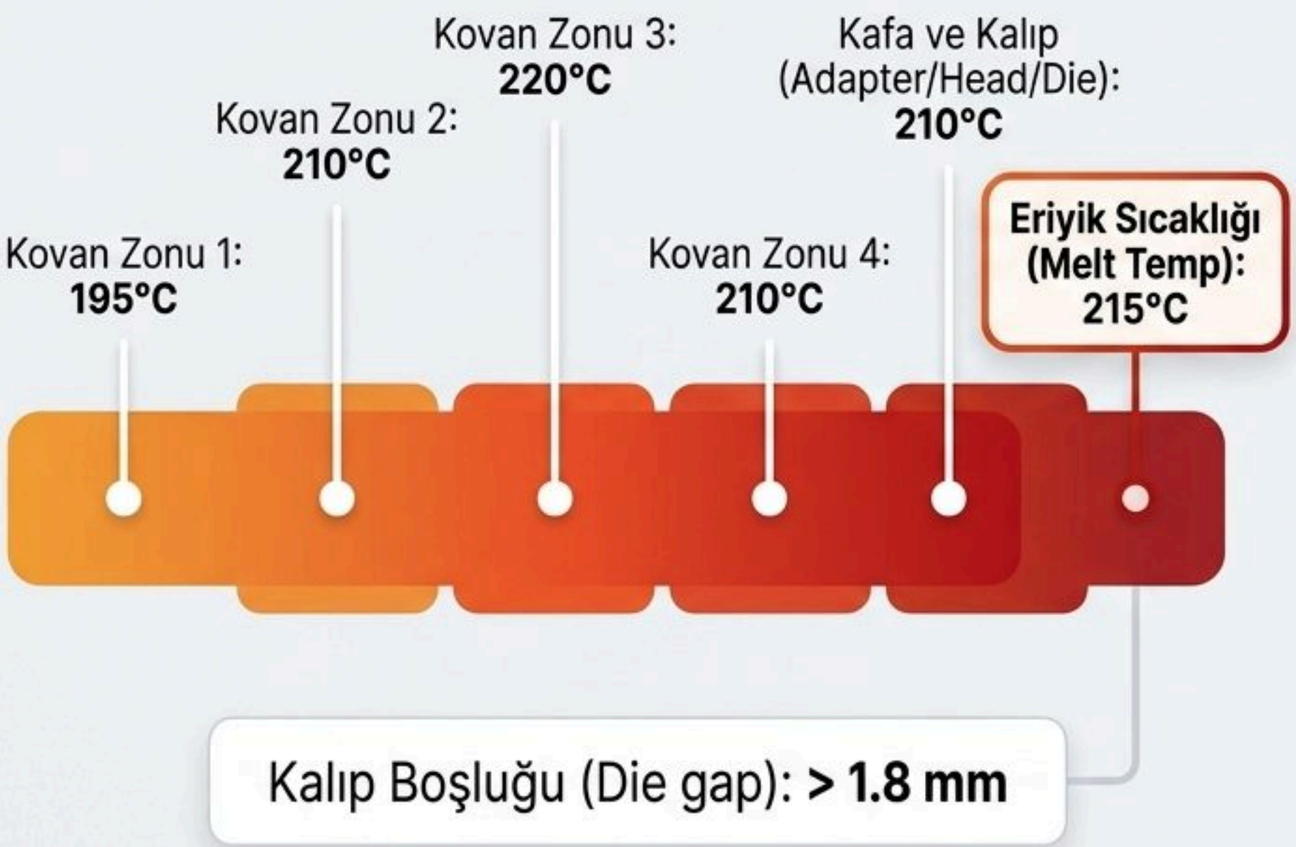
Sert ve Dik Duran Yapılar İsteniyorsa:

Projenizde yüksek esneklik ve tokluk yerine; sertlik ve rijitlik (örneğin HDPE karakteristiği) aranıyorsa.

NotebookLM

İşleme ve Depolama Rehberi

Maksimum verim ve güvenli operasyon için temel parametreler.



Statik ve Patlama Riski

Toz ve partikül birikimi patlama tehlikesi yaratabilir. Geleneksel sistemlerde birikimi önleyin ve tüm ekipmanların topraklandığından emin olun.

Depolama Şartları

Pelet formundaki ürün; ısıdan, doğrudan güneş ışığından ve tozdan uzak, serin, kuru ve gölgeli alanlarda stoklanmalıdır.

NotebookLM

MALZEME PASAPORTU ÖZETİ

EFDC-7087 Karar Özeti

“İncelebildiği kadar sağlam.”

Güç
Delinme direnci ve tokluğun mükemmel kombinasyonu.

Maliyet Etkinliği
İnce gauge yapabilme özelliği sayesinde (draw down) hammadde optimizasyonu.

Çok Yönlülük
Pişirme dayanımlı gıda temasından, endüstriyel kılıflara uzanan güvenli kullanım.

Paketleme Seçenekleri: 25 kg güvenli palet torbaları (1.375 MT net) veya 15 MT kapasiteli deniz dökme (sea bulk) konteynerleri.

Daha detaylı güvenlik ve test metotları için lütfen orijinal EQUATE Teknik Veri Föyüne (TDS) başvurunuz.

NotebookLM